

②

(19) JAPANESE PATENT OFFICE

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: **09064049 A**(43) Date of publication of application: **07.03.97**

(51) Int. Cl. **H01L 21/321**
H01L 21/301
H01L 23/12
H01L 23/29
H01L 23/31

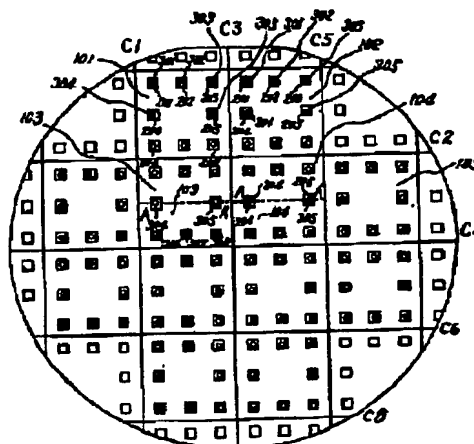
(21) Application number: **07221760**(22) Date of filing: **30.08.95**(71) Applicant: **OKI ELECTRIC IND CO LTD**(72) Inventor: **SHIBATA SUSUMU**
SUZUKI MASAMI(54) **CHIP SIZE PACKAGE AND MANUFACTURE THEREOF**

(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To reduce the cost and to sufficiently protect an LSI by decreasing the number of steps without using a mold.

SOLUTION: Bumps 301 to 308 are formed at the electrodes 201 to 308 of LSIs 101 to 104 formed on a wafer, the peripheries of the bumps are covered with resin, solder balls to be connected to the bumps are formed, and cutting process for the individual LSIs is taken to obtain a chip size package.

COPYRIGHT: (C)1997,JPO



(19) 日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開平 9-64049

(43) 公開日 平成9年(1997)3月7日

(51) Int. Cl. ⁶	識別記号	庁内整理番号	F I	技術表示箇所
H 0 1 L	21/321		H 0 1 L 21/92 6 0 2 L	
	21/301		21/78 L	
	23/12		21/92 6 0 2 Z	
	23/29		6 0 2 D	
	23/31		6 0 4 A	
審査請求 未請求 請求項の数 9			O L	(全 9 頁) 最終頁に続く

(21) 出願番号 特願平 7-221760

(22) 出願日 平成7年(1995)8月30日

(71) 出願人 000000295

沖電気工業株式会社
東京都港区虎ノ門1丁目7番12号

(72) 発明者 柴田 進

東京都港区虎ノ門1丁目7番12号 沖電気工業株式会社内

(72) 発明者 鈴木 正美

東京都港区虎ノ門1丁目7番12号 沖電気工業株式会社内

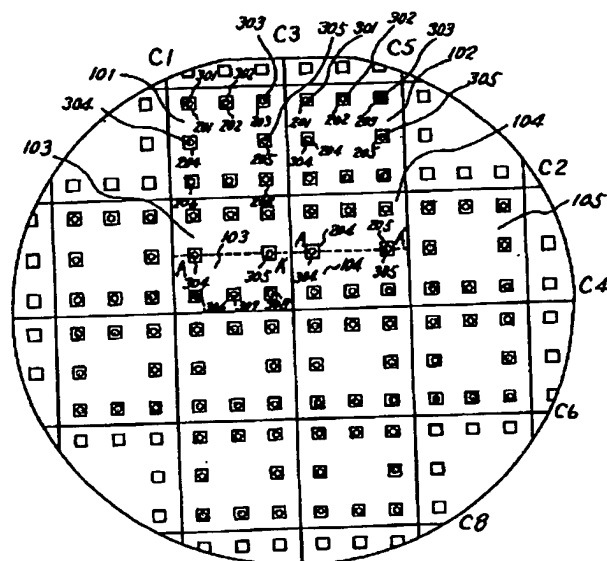
(74) 代理人 弁理士 清水 守 (外1名)

(54) 【発明の名称】 チップサイズパッケージ及びその製造方法

(57) 【要約】

【課題】 金型を用いることなく、工程数を低減して、低価格化を図ることができ、LSIの保護を十分なものとする。

【解決手段】 ウエハに形成されるLSI101~104の電極201~208にパンプ301~308を形成し、これらのパンプの周囲に樹脂を被着し、そのパンプに接続される半田ボールを形成した後、個々のLSIを切り出して、チップサイズパッケージを得る。



【特許請求の範囲】

【請求項 1】 (a) L S I の電極に接続されるパンプと、 (b) 該パンプの周囲を覆う樹脂と、 (c) 前記パンプに接続される半田ボールとを具備することを特徴とするチップサイズパッケージ。

【請求項 2】 請求項 1 記載のチップサイズパッケージにおいて、前記パンプとしてスタッドパンプを用いることを特徴とするチップサイズパッケージ。

【請求項 3】 請求項 1 記載のチップサイズパッケージにおいて、前記樹脂表面上または L S I 表面上に配線金属を形成して、前記 L S I の電極の位置と前記半田ボールの位置とを平面的に異ならせるようにしたことを特徴とするチップサイズパッケージ。

【請求項 4】 (a) ウエハに複数の L S I を形成する工程と、 (b) 前記 L S I の個々の電極に接続されるパンプを形成する工程と、 (c) 前記パンプの周囲に樹脂を被着する工程と、 (d) 前記パンプに接続される半田ボールを形成する工程と、 (e) 個々の L S I を切り出す工程とを施すことを特徴とするチップサイズパッケージの製造方法。

【請求項 5】 (a) ウエハに複数の L S I を形成する工程と、 (b) 前記 L S I に樹脂を被着する工程と、 (c) 前記樹脂を部分的にエッチング除去する工程と、 (d) 前記樹脂の除去された部分にパンプを形成する工程と、 (e) 前記パンプに接続される半田ボールを形成する工程と、 (f) 個々の L S I を切り出す工程とを施すことを特徴とするチップサイズパッケージの製造方法。

【請求項 6】 (a) ウエハに複数の L S I を形成する工程と、 (b) 前記 L S I の個々の電極に接続されるパンプを形成する工程と、 (c) 前記パンプに固着される金属板を設ける工程と、 (d) 前記 L S I の表面と前記金属板の間に樹脂を注入硬化する工程と、 (e) 前記金属板をエッチング除去して配線金属を形成する工程と、 (f) 前記配線金属に接続される半田ボールを形成する工程と、 (g) 個々の L S I を切り出す工程とを施すことを特徴とするチップサイズパッケージの製造方法。

【請求項 7】 請求項 4、5 又は 6 記載のチップサイズパッケージの製造方法において、L S I を機械的に補強するため、L S I をウエハから切り出す前に前記ウエハ全面に補強板を接着することを特徴とするチップサイズパッケージの製造方法。

【請求項 8】 請求項 4、5 又は 6 記載のチップサイズパッケージの製造方法において、前記樹脂としてエポキシ樹脂を用いることを特徴とするチップサイズパッケージの製造方法。

【請求項 9】 請求項 4、5 又は 6 記載のチップサイズパッケージの製造方法において、樹脂としてポリイミド樹脂を用いることを特徴とするチップサイズパッケージの製造方法。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は、L S I のパッケージに係り、特に、L S I チップと略同じ大きさのチップサイズパッケージ及びその製造方法に関するものである。

【0002】

【従来の技術】従来、このような分野の技術としては、例えば、

(1) “日経マイクロデバイス” 1995 年 2 月号

P. 96~97

(2) “チップサイズパッケージ技術” サーキットテクノロジー Vol. 9

No. 7 P 475~478 に記載されるようなものがあつた。

【0003】従来、この種のパッケージは、 μ -BG A、チップサイズパッケージ、CSP 等種々の名前で呼ばれ、また色々なタイプのチップサイズパッケージが開発されている。図 8 はかかる従来のチップサイズパッケージの一部破断斜視図である。この図に示すように、L S I チップ 1 に半田蒸着と銅パンプを形成後、モールド樹脂 2 により樹脂封止し、外部端子用の半田パンプ 3 をつける。なお、4 は配線パターン、5 は電極パッドである。結果として、略 L S I と同じ大きさのパッケージを得ることができる。

【0004】また、図 9 は従来のチップサイズパッケージのうちテープキャリア方式の一部破断斜視図である。この図において、L S I チップ 5 の表面には弾性のある接着剤 6 をコートし、L S I の各パッドにはフレキシブル配線 7 を接続し、且つこのフレキシブル配線 7 には半田パンプ 9 が形成されている。この半田パンプ 9 の周囲には、ポリイミドフィルム 8 等で形成され、前記した弾性のある接着剤 6 でこの L S I に固定されている。10 は保護枠である。結果として、略 L S I と同じ大きさのパッケージを得ることができる。

【0005】すなわち、このパッケージでは、L S I をパンプを有するポリイミド配線基板に実装し、次に、これを目的の配線基板に実装する形態をとっていた。他の形態のパッケージにおいても、配線が施された L S I チップを、配線基板に実装するようにしている。

【0006】

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上記したように、従来のチップサイズパッケージでは、L S I をウエハから切り出した後、各々のチップサイズパッケージを作製することになるので、専用の金型を必要とし、低価格化の障害となっていた。また、従来のチップサイズパッケージでは、L S I を配線基板に実装するのに 2 回実装することとなり、工程数が多くなり、結果として高価格になる。

【0007】更に、L S I をウエハから切り出した後、

3
各々のチップサイズパッケージを作製することとなるので、その作製が煩雑であり、製造の信頼性上も問題である。また、従来エポキシ樹脂のモールドに関してはモールドに離型剤が添加されていた。これは金型と樹脂との接着を防ぐ目的のものであるが、LSI及びその周辺の金属との接着力が弱くなり、信頼性低下につながった。

【0008】更に、今までにもLSIにバンプを直接作製し、これをフェースダウン方式で基板に実装する方法は提案され、実用化している。しかし、この方法ではLSIの保護が全くなされておらず、機械的にも弱いものであった。本発明は、上記問題点を除去し、金型を用いることなく、工程数を低減して、低価格化を図ることができ、LSIの保護が十分なチップサイズパッケージ及びその製造方法を提供することを目的とする。

【0009】

【課題を解決するための手段】本発明は、上記目的を達成するために、

(1) チップサイズパッケージにおいて、LSIの電極に接続されるバンプと、このバンプの周囲を覆う樹脂と、前記バンプに接続される半田ボールとを設けるようにしたものである。

【0010】したがって、LSIチップと同じ面積のチップサイズパッケージを得ることができる。また、樹脂をチップ表面に被着しているのので、いわゆる樹脂モールドとほぼ同じ信頼性を保証できる。すなわち、パッケージは小さいままで、強度的にも、耐湿等においても、いわゆるモールドパッケージと同等の信頼性を確保することができる。

【0011】(2) 上記(1)記載のチップサイズパッケージにおいて、前記バンプとしてスタッドバンプを用いるようにしたものである。したがって、上記(1)に加え、LSIの表面の強度と接続の信頼性を高めることができる。

(3) 上記(1)記載のチップサイズパッケージにおいて、前記樹脂表面上またはLSI表面上に配線金属を形成して、前記LSIの電極の位置と前記半田ボールの位置とを平面的に異ならせるようにしたものである。

【0012】したがって、上記(1)に加え、LSIのパッド電極と半田ボールとの位置を任意に変更でき、接続の自由度を高めることができる。

(4) チップサイズパッケージの製造方法において、ウエハに複数のLSIを形成する工程と、前記LSIの個々の電極に接続されるバンプを形成する工程と、前記バンプの周囲に樹脂を被着する工程と、前記バンプに接続される半田ボールを形成する工程と、個々のLSIを切り出す工程とを施すようにしたものである。

【0013】したがって、パッケージ化の作業を全てウエハ単位で行えるため、工数が少なく、低価格化を実現できる。このように、ウエハのカッティングを最後に行うので、各パッケージ当たりの工数が少なくなり、低価

格化を実現できる。

(5) チップサイズパッケージの製造方法において、ウエハに複数のLSIを形成する工程と、前記LSIに樹脂を被着する工程と、前記樹脂を部分的にエッチング除去する工程と、前記樹脂の除去された部分にバンプを形成する工程と、前記バンプに接続される半田ボールを形成する工程と、個々のLSIを切り出す工程とを施すようにしたものである。

【0014】したがって、上記(4)と同様に、パッケージ化の作業を全てウエハ単位で行えるため、工数が少なく、低価格化を実現できる。

(6) チップサイズパッケージの製造方法において、ウエハに複数のLSIを形成する工程と、前記LSIの個々の電極に接続されるバンプを形成する工程と、前記バンプに固着される金属板を設ける工程と、前記LSIの表面と前記金属板の間に樹脂を注入硬化する工程と、前記金属板をエッチング除去して配線金属を形成する工程と、前記配線金属に接続される半田ボールを形成する工程と、個々のLSIを切り出す工程とを施すようにしたものである。

【0015】したがって、上記(4)と同様に、パッケージ化の作業を全てウエハ単位で行えるため、工数が少なく、低価格化を実現できる。

(7) 上記(4)、(5)又は(6)記載のチップサイズパッケージの製造方法において、LSIを機械的に補強するため、LSIをウエハから切り出す前に前記ウエハ全面に補強板を接着するようにしたものである。

【0016】このように、LSIをウエハから切り出す前に前記ウエハ全面に補強板を接着するようにしたので、LSIを機械的に補強することができ、確実なウエハから切り出しを行うことができる。

(8) 上記(4)、(5)又は(6)記載のチップサイズパッケージの製造方法において、前記樹脂としてエポキシ樹脂を用いるようにしたものである。

【0017】この実施例では、金型を用いないので、エポキシ樹脂に離型剤を添加する必要はない。また、樹脂との接着を促進するシランカップリング剤等を有効に用いることができた。また、エポキシ樹脂のLSIへの接着力も十分なものが得られる。

(9) 上記(4)、(5)又は(6)記載のチップサイズパッケージの製造方法において、樹脂としてポリイミド樹脂を用いるようにしたものである。

【0018】したがって、上記(8)と同様な、チップサイズパッケージを製造することができる。

【0019】

【発明の実施の形態】以下、本発明の実施例について図面を参照しながら説明する。図1は本発明の第1実施例を示すウエハの平面図、図2は図1のA-A'線におけるチップの製造工程断面図である。図1においては、1枚のウエハが示されており、前処理を終了し、更に各し

LSIの電極にパンプを形成した状態を示している。

【0020】この図において、101, 102, 103, 104…は各LSIであり、実線C1, C3, C5, C2, C4, C6, C8に沿ってウエハから切り取られる。201, 202, 203, 204, 205…は各LSIにおける電極であり、通常は1μm厚のアルミニウムが用いられる。301, 302, 303…はパンプであり、この実施例では、いわゆるスタッド方式（ワイヤボンディングの技術を用い、ボンディング時のボールをパンプとする）を用いた。

【0021】また、電極201, 202, 203, 204, 205…は、各々1辺が50~100μmの長方形または正方形の形状をなしており、パンプ301, 302, 303…は通常各々最大直径が30~60μmで高さもほぼ同じ値である。以下、図1に示されるLSI104のA-A'線に沿ったウエハサイズチップの製造方法について図2を参照しながら説明する。

【0022】(1) まず、図2(a)に示すように、100はLSI104を保護するためのPSG膜（酸化膜）であり、電極204, 205上のパンプ304, 305はワイヤボンディング技術で作製されるので先端がくびれた形状になっている。次工程前に1パンプ当たり6~10gの加重をかけ、各パンプの高さを揃え、また各パンプの先端の表面を平坦にしておく都合がよい。

【0023】パンプの材質としては金、または銅が望ましい。両者とも、通常の技術で作製することができる。特に、金のスタッド方式のパンプに関しては、製造装置も販売され、LSIの前工程を変更することなく作製することができる。また、銅パンプに関してはボンディング時、Arに水素を添加したガス雰囲気が必要であり、またボンディング圧力も若干大きめなため、LSIのアルミ電極の厚さを2μm程度と通常より厚くする必要が生じたが、条件を最適化することにより、良好な銅のスタッド方式のパンプを得ることが可能であった。

【0024】最近、錫-鉛を主成分にした半田ワイヤをボンディングして、半田のパンプをLSIのアルミ電極に形成する技術も実用化されている。この技術を用いると容易に半田パンプ301, 302, 303, 304, 305…を形成することができ、更に続行する工程も容易になる。

(2) 全てのアルミ電極にパンプを形成、加圧後、図2(b)に示すように、ウエハ全面にエポキシ樹脂200を被着し、ホットプレスにより押圧、加熱しつつ硬化させる。プレスによる圧力は、15~20kg重/cm²、温度は80~100℃、硬化時間にほぼ1時間を要した。この押圧工程により、パンプ301, 302, 303, 304, 305…等の平らな突起上面がエポキシ樹脂200の表面に露出する。用いた樹脂はエコボンド（エマーソンアンドカミング社製の商品名）のように硬化前後における体積変化率の低いものを用いた。樹脂

によりまた押圧条件により、パンプ301, 302, 303, 304, 305…等の平らな突起上面にエポキシ樹脂200が薄く残存する場合がある。この時は表面をサンドペーパー、またはサンドブラスト等で若干研磨することで露出させることができた。

【0025】(3) 次に、通常の工程により、図2

(c)に示すように、パンプ301, 302, 303, 304, 305…等の平らな突起上面に半田ボール604, 605を設置する。エポキシ樹脂200上に半田レジストが存在してもよい。これらの工程はウエハ全域にわたって行われる。半田ボール設置後、図1の実線C1, C3, C5, C2, C4, C6, C8に沿ってウエハをカッティングする。

【0026】上記のようにして、カッティングを行ったチップサイズパッケージを以下に示す。図3は本発明の第1実施例を示すチップサイズパッケージの斜視図である。この図の点線で示した50は、このチップサイズパッケージを補強するための補強板である。このチップサイズパッケージは、表面にエポキシ樹脂をコーティングしているので十分な強度を持つが、使用する前においては、更なる強度を必要とする場合がある。ウエハカッティング前、補強板50を張り付けることにより、極少ない工程で、補強板付きチップサイズパッケージを得ることができる。

【0027】この様な構造になっているから、LSIチップと同じ面積である。本発明によれば、このパッケージは小さいままで、強度的にも、耐湿等においてもいわゆるモールドパッケージと同等の信頼性を持つものである。次に、本発明の第2実施例について説明する。図4は本発明の第2実施例を示すウエハのチップとなる部分の平面図、図5はそのウエハのチップの断面図（図4のB-B'断面図）、図6は本発明の第2実施例を示すチップサイズパッケージの斜視図である。なお、第1実施例と同じ部分については、同じ符号を付してそれらの説明は省略する。

【0028】これらの図において、402, 404, 405, 407はエポキシ樹脂200上に形成された配線金属であり、半田ボールの位置をアルミ電極の真上の位置から移動させるためのものである。この配線金属を形成する工程は、例えばアルミニウム蒸着、ホトリソ、エッチング工程で行えばよく、なんら新しい技術は使用しない。メッキ技術によってもよい。半田ボール601, 602, 603, 604, 605, …を設置するため半田レジスト500を形成する。

【0029】この実施例では、第1実施例のように、接続用の半田ボールをLSIのアルミ電極の真上に形成するのではなく、平面的に離れた場所に形成する。図5に示すように、まず、第1実施例のように、LSI104の各アルミ電極204, 205上に、スタッドパンプ304, 305をたて、次に、エポキシ樹脂200を被

着、押圧、加熱して、加工後、このエポキシ樹脂表面に配線金属 404、405 を形成し、更に半田レジスト 500 を塗布後、半田ボール 604、605 を設置する。

【0030】最後にウェハをカッティングして LSI を切り出す。このように、半田ボール形成後、一枚のウェハをカッティングした一個の LSI に相当する部分を拡大すると、図 6 のようになる。この実施例では、パンプ形成後、半田ボール移動のための配線金属の形成を行った。エポキシ樹脂形成前に半田ボール移動のための配線金属の形成を行うことも可能である。

【0031】図 7 はかかる本発明の第 3 実施例を示す配線金属の形成を先に行った場合のチップサイズパッケージの要部断面図である。図 5 と同じ部分については、同じ符号を付してそれらの説明は省略する。この図において、704、705 は半田ボールの位置を移動するための配線金属、804、805 はパンプである。

【0032】上記実施例によれば、接続用の半田ボールが所望の場所にあるチップサイズパッケージを容易に得ることが可能である。特に、第 1 実施例と同様に、ウェハのカッティングを最後に行うようにしたので、各パッケージ当たりの工数が少なくなり、低価格化を実現できる。また、エポキシ樹脂の LSI への接着力も十分なものが得られる。

【0033】第 1 実施例、第 2 実施例共にパンプはスタッドパンプとして説明した。しかし通常のメッキによるパンプを用いても、十分に本発明を実施することが可能であった。また、第 1 実施例、第 2 実施例はパンプ形成後、樹脂封止する工程を用いている。しかし、樹脂を全面に被着後、この樹脂を部分的に必要箇所に応じてホトリソ技術等で除去し、除去箇所に無電解メッキなどでパンプを形成する手法も有効であった。

【0034】図 10～図 12 は本発明の第 4 実施例を示す図であり、図 10 は本発明の第 4 実施例を示すチップサイズパッケージの製造工程断面（図 11 の C-C' 線断面）図、図 11 はそのチップサイズパッケージの平面図、図 12 はそのチップサイズパッケージの斜視図である。ウェハの全体平面図は、第 1 実施例と同様であるのでここでは図示は省略する。

【0035】以下、そのチップサイズパッケージの製造方法を図 10 を用いて説明する。

(1) まず、図 10 (a) に示すように、LSI 104 を保護するための PSG 膜（酸化膜）100 が形成される。アルミ電極 204、205 に接続されるパンプ 304、305 はワイヤボンディング技術で作製されるので先端がくびれた形状になっている。

【0036】パンプの材質としては金、または銅が望ましい。両者とも、通常の技術で作製することができる。特に、金のスタッド方式のパンプに関しては、製造装置も販売され、LSI の前工程を変更することなく作製することができる。また、銅パンプに関してはボンディン

グ時 Ar に水素を添加したガス雰囲気が必要であり、またボンディング圧力も若干大きめなため、LSI のアルミ電極の厚さを $2\mu\text{m}$ 程度と通常より厚くする必要が生じたが、条件を最適化することにより、良好な銅のスタッド方式のアルミニウムを得ることが可能であった。

【0037】最近、錫-鉛を主成分にした半田ワイヤをボンディングして半田のパンプを LSI のアルミ電極に形成する技術も実用化されている。この技術を用いると容易に半田パンプ 304、305…を形成することができ、更に続行する工程も容易になる。

(2) 次に、図 10 (b) に示すように、全ての LSI 104 のアルミ電極 204、205 にパンプ 304、305 を形成し、加圧による先端平坦化後、このウェハ全面に銅箔 1400（例えば、 $15\mu\text{m}$ の厚さ）を鍍付けする。この銅箔 1400 表面に、予め錫あるいは半田等（図示なし）を $1\mu\text{m}$ 程度の厚さにメッキしておき、このメッキ膜とパンプ 304、305 とを低温鍍付けする。

【0038】次に、この銅箔 1400 と LSI 104 間にエポキシ樹脂 1200 を注入、加熱硬化させる。用いた樹脂は、エコボンド（エマーソンアンドカミング社製の商品名）のように、硬化前後における体積変化率の低いものを用いた。LSI 104 と銅箔 1400 間の距離は $40\mu\text{m}$ 前後であるから、毛細管現象により効率よく、また、確実に樹脂を充填でき、また、LSI 104 表面、銅箔 1400 面との接着性も極めて良好であった。なお、パンプ材料が半田である場合は、銅箔に予め錫、半田等をメッキしなくても容易にパンプと銅箔を接続できた。

【0039】(3) 次に、図 10 (c) に示すように、銅箔 1400 をエッチング加工し、所望の配線金属 1404、1405 をエポキシ樹脂 1200 上に形成した。銅箔 1400 のエッチング加工は、例えば、感光性のドライフィルムを銅箔 1400 にコーティング後、マスクを用いて露光、現像等の処理を行った後、塩化第二鉄の溶液による銅の選択エッチングにより行った。

【0040】(4) 次に、電極 1404、1405 を形成後、半田ボールを設置するため半田レジスト 1500 を塗布し、その後、半田ボール 604、605 を所定の場所に設置する。このようにして得られたチップサイズパッケージの平面を図 11 に示す。この図において、1401、1402、1403、1404、1405…は樹脂 1200 上に形成された銅箔からなる配線金属であり、601、602…は半田ボールである。

【0041】LSI のアルミ電極 201、203、206、208 についてはその真上に外部回路との接続点を設置するようにしてある。アルミ電極 204、205 については、それぞれの場所に設置されたパンプ（304、305 等）を通して、外部回路との接続点を移動するよう設計されている。半田ボール 601、602、6

10

20

30

40

50

03、604、605、…の設置後、図1のように、点線C1、C3、C5、C2、C4、C6、C8に沿ってウエハをカッティングする。カッティング後のLSI104が図12に示されている。

【0042】図12に示した700は、このチップサイズパッケージを補強するための補強板である。このチップサイズパッケージは表面にエポキシ樹脂をコーティングしているので十分な強度を持つが、使用する前においては、さらなる強度を必要とする場合がある。ウエハカッティング前、補強板700を張り付けることにより、極少ない工程で、補強板700付きチップサイズパッケージを得ることが可能である。

【0043】また、エポキシ樹脂をチップ表面に被着しているの、いわゆる樹脂モールドと略同じ信頼性を保証できる。従来文献に示したように、従来のチップサイズパッケージはLSIのダイスカッティング後、パッケージを行っていた。しかし、本発明ではパッケージ化の作業を全てウエハ単位で行えるため、工数が少なく、低価格化を実現できる。

【0044】従来のエポキシ樹脂のモールドに関してはモールドに離型剤が添加されていた。これは金型と樹脂との接着を防ぐ目的のものであるが、LSI及びその周辺の金属との接着力が弱くなり信頼性低下につながった。しかし、本発明の技術では金型を用いないので、エポキシ樹脂に離型剤を添加する必要はない。また、樹脂との接着を促進するシランカップリング剤等を有効に用いることができた。

【0045】本発明によれば、このパッケージは小さいままで、強度的にも、耐湿等においてもいわゆるモールドパッケージと同等の信頼性を持つものである。本発明においては、バンパはスタッド方式として説明した。しかし通常のメッキによるバンパを用いることも当然可能であり、他の手法でもよい。またバンパの材料も銅、金、錫鉛半田のみでなく、他の材料の使用も可能である。

【0046】ウエハ全面のバンパに張り付ける箔を銅箔として説明したが、これ以外に金箔、コパール板等を用いても良好なチップサイズパッケージを得ることができた。また、各バンパとの接続は、低温鐙付けではなく、高温圧接、超音波接続等を用いても可能であった。この場合、銅箔に半田メッキ、錫メッキ等は不要であった。

【0047】銅箔のパターニングはドライフィルムを用いる手法で説明したが、レジストをコーティングする手法等の方法でも十分対応しえるものである。銅箔とLSI間にエポキシ樹脂を毛細管現象で注入したが、例えばポリイミド樹脂等、他の系統の樹脂でも対応可能である。外部回路との接続は半田ボールで行うとして説明したが、接続予定場所に金属片を溶接して接続端子とすることも可能である。あるいは導電性塗料を必要箇所に塗布してもよい。

【0048】なお、本発明は上記実施例に限定されるものではなく、本発明の趣旨に基づいて種々の変形が可能であり、これらを本発明の範囲から排除するものではない。

【0049】

【発明の効果】以上、詳細に説明したように、本発明によれば、以下のような効果を奏することができる。

(1) 請求項1記載の発明によれば、LSIチップと同じ面積のチップサイズパッケージを得ることができる。

10 【0050】また、樹脂をチップ表面に被着しているの、いわゆる樹脂モールドとほぼ同じ信頼性を保証できる。すなわち、パッケージは小さいままで、強度的にも、耐湿等においても、いわゆるモールドパッケージと同等の信頼性を確保することができる。

(2) 請求項2記載の発明によれば、上記(1)の効果に加え、LSIの表面の強度と接続の信頼性を高めることができる。

20 【0051】(3) 請求項3記載の発明によれば、上記(1)の効果に加え、LSIのパッド電極と半田ボールとの位置を任意に変更でき、接続の自由度を高めることができる。

(4) 請求項4記載の発明によれば、パッケージ化の作業を全てウエハ単位で行えるため、工数が少なく、低価格化を実現できる。

【0052】このように、ウエハのカッティングを最後に行うので、各パッケージ当たりの工数が少なくなり、低価格化を実現できる。

30 (5) 請求項5記載の発明によれば、上記(4)と同様に、パッケージ化の作業を全てウエハ単位で行えるため、工数が少なく、低価格化を実現できる。

(6) 請求項6記載の発明によれば、上記(4)と同様に、パッケージ化の作業を全てウエハ単位で行えるため、工数が少なく、低価格化を実現できる。

【0053】(7) 請求項7記載の発明によれば、上記(4)、(5)又は(6)の効果に加え、LSIをウエハから切り出す前に、そのウエハ全面に補強板を接着するようにしたので、LSIを機械的に補強することができ、確実なウエハから切り出しを行うことができる。

40 (8) 請求項8記載の発明によれば、金型を用いないので、エポキシ樹脂に離型剤を添加する必要はない。また、樹脂との接着を促進するシランカップリング剤等を有効に用いることができた。

【0054】(9) 請求項9記載の発明によれば、上記(8)と同様な、チップサイズパッケージを製造することができる。

【図面の簡単な説明】

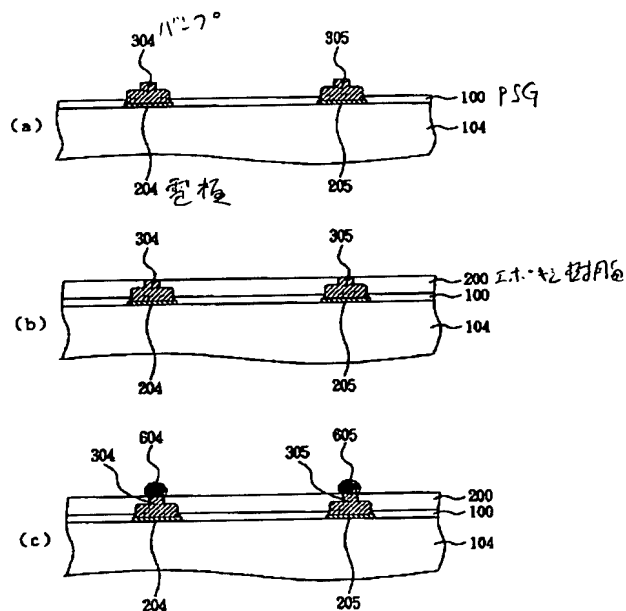
【図1】本発明の第1実施例を示すウエハの平面図である。

50 【図2】図1のA-A'線におけるチップの製造工程断面図である。

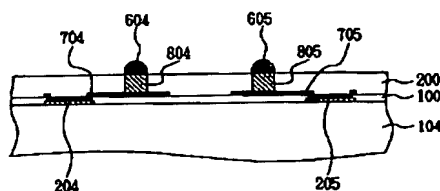
【図 1 1】 本発明の第 4 実施例を示すチップサイズパッ

1 4 0 0 銅箔

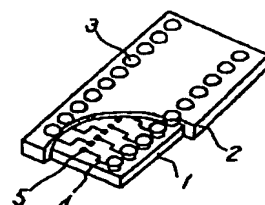
【图 2】



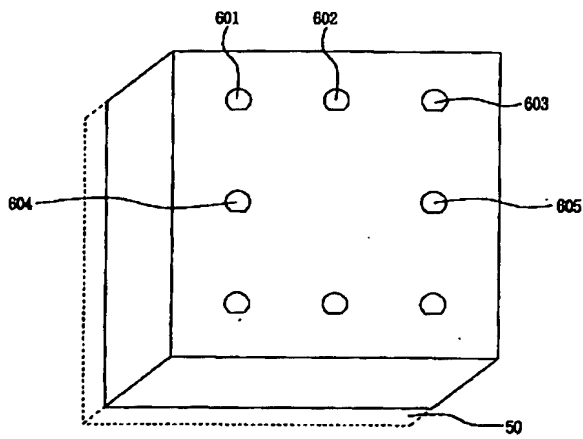
【図 7】



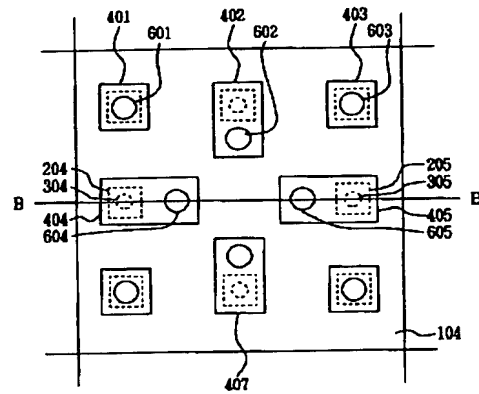
【图8】



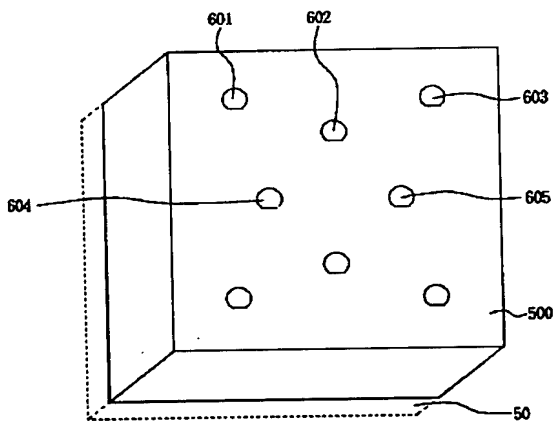
【図3】



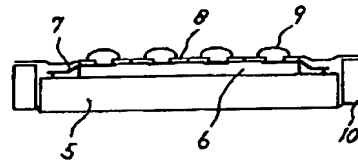
【図4】



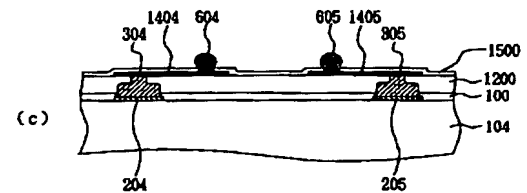
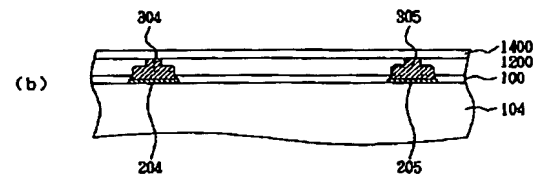
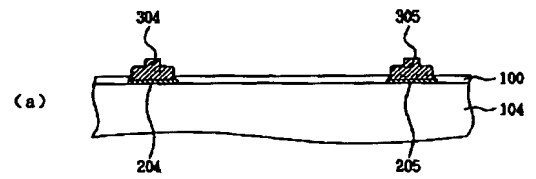
【図6】



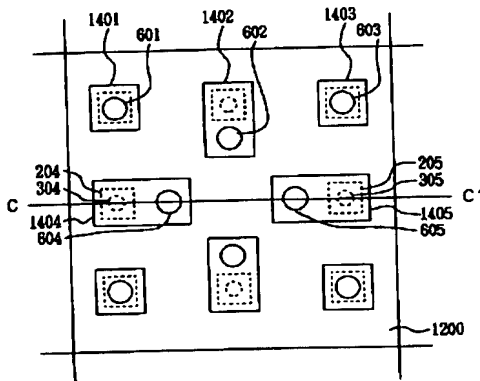
【図9】



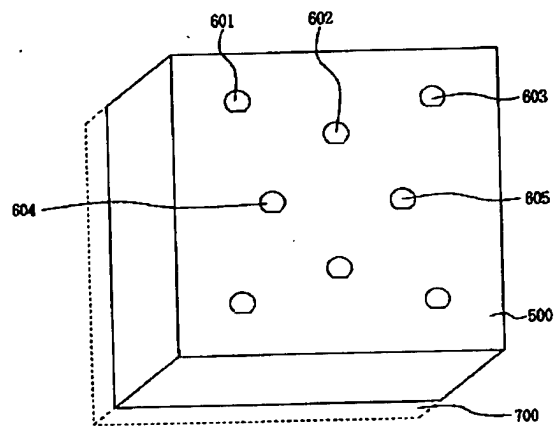
【図10】



【図11】



【図 12】



フロントページの続き

(51) Int. Cl.⁶

識別記号

庁内整理番号

F I

H 0 1 L 23/12

23/30

技術表示箇所

L

D